

掃描 & 加入 群聯IR發送清單



**PHISON**

# 營運成果與未來展望

## 2021年 第二季

潘健成 | 群聯電子董事長

August 6, 2021

# 免責聲明

本新聞稿所提供之資訊(除歷史資訊之外)屬於預測性陳述。在此敬告讀者，預測性陳述乃基於群聯之合理認知以及就現狀所作的預估，且將受到各種風險以及不確定因素影響，因此可能造成實際結果和預測性陳述之內容顯著不同。這些風險以及不確定性因素包括但不限於，供給與需求變化、產銷能力、開發成功、及時導入市場、市場競爭、產業循環、客戶財務狀況、匯率浮動、法律訴訟、法令變更、全球經濟變化、自然災害、其他可能會影響群聯業務與營運的不確定因素。鑑於此，讀者請勿倚賴預測性陳述。除法律另有規定外，無論是基於新資訊、未來事件或是其他因素，群聯皆無義務更新預測性陳述。

# 簡報大綱

1

群聯的營運轉型

2

財務表現與營運概況更新

3

營運亮點

4

現在與未來的技術領先優勢

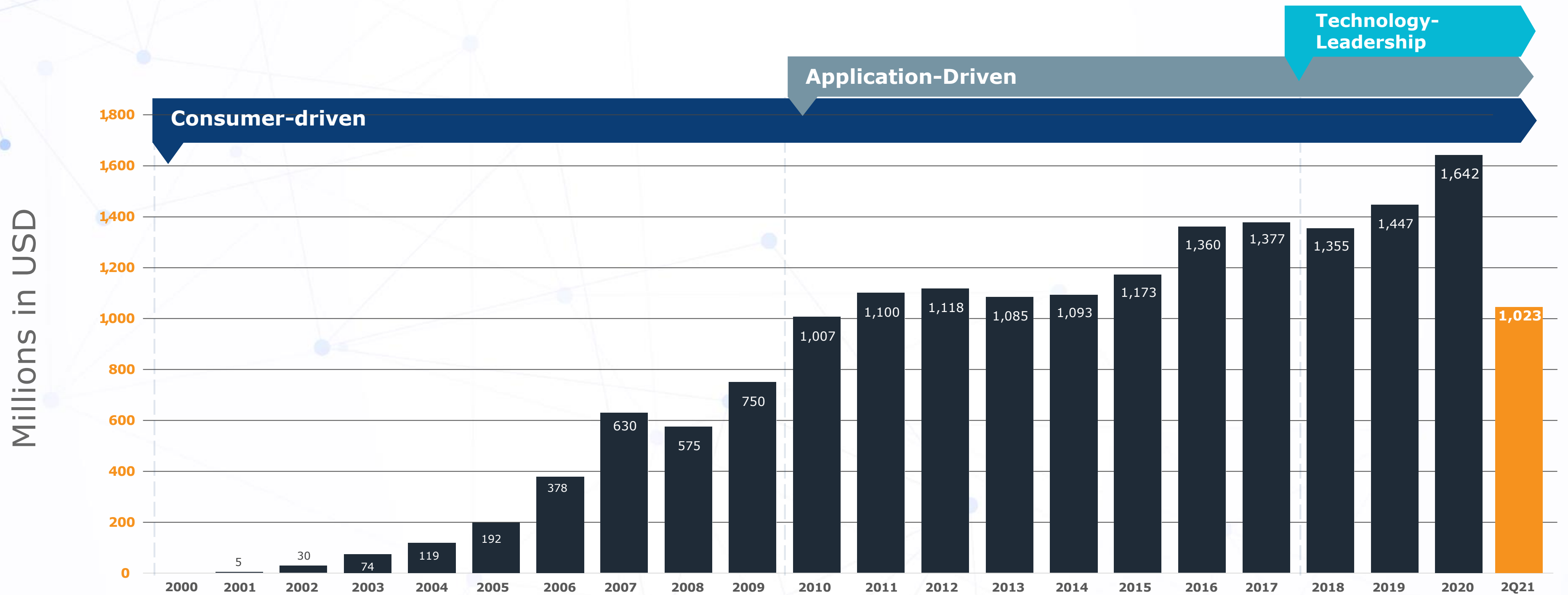
5

Q&A

# **1** 群聯的營運轉型

# 群聯已成功轉型 成為應用與技術導向的儲存解決方案供應商

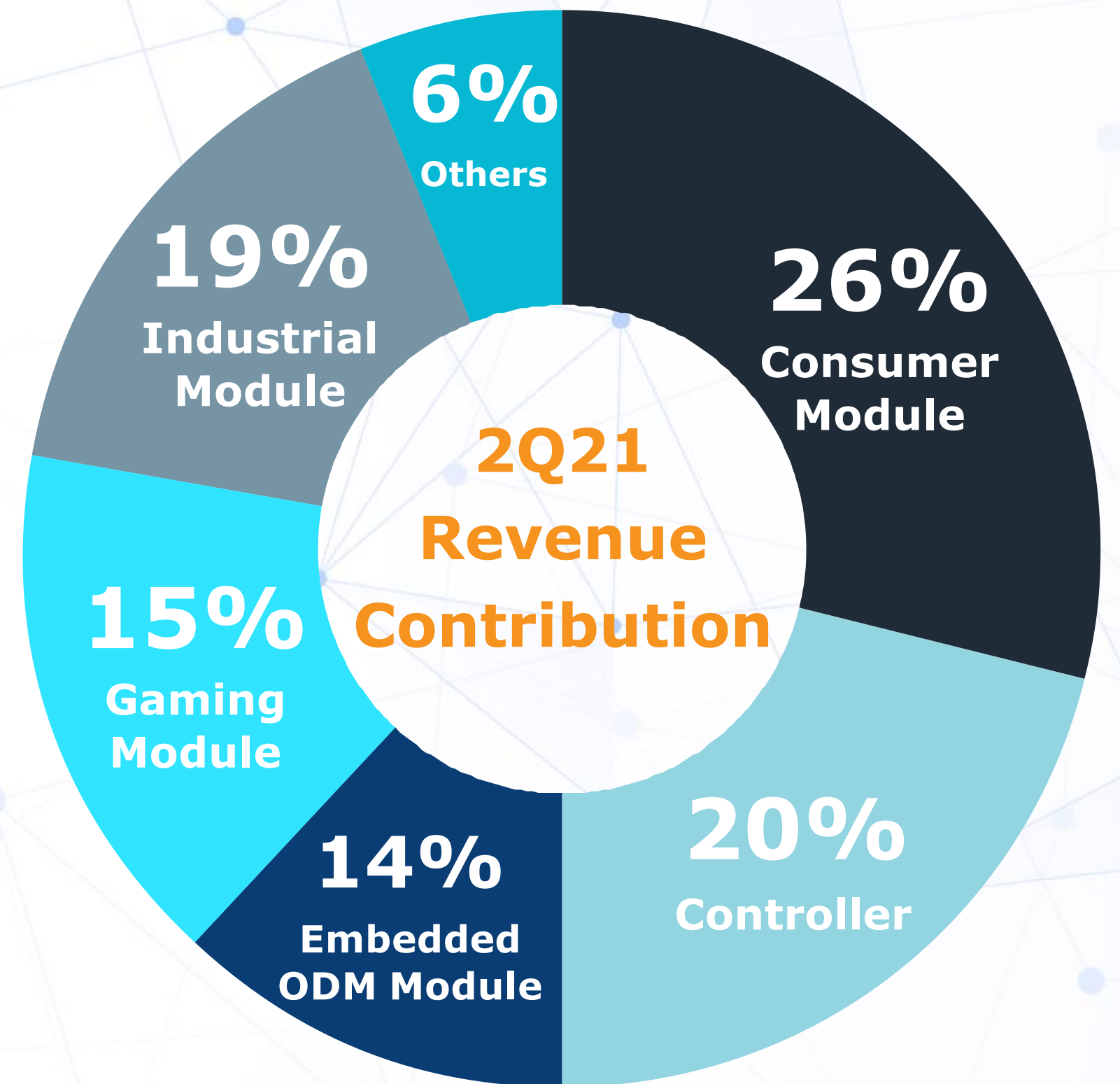
Gaming Enterprise Automotive Industrial Embedded ODM



# 群聯耕耘全方位儲存應用市場有成

# 70%

revenue from non-consumer products



## **2** 2Q21財務表現與營運概況更新

# 2Q21 合併營收與毛利

2021年第二季合併營收  
**\$159億**

營收 季成長23%

創歷史同期新高  
創歷史單季新高

2021年第二季毛利  
**\$51.6億**

毛利 季成長36%

創歷史同期新高  
創歷史單季新高

\*營收單位為新台幣



## 2Q21 營運成果

### 控制晶片

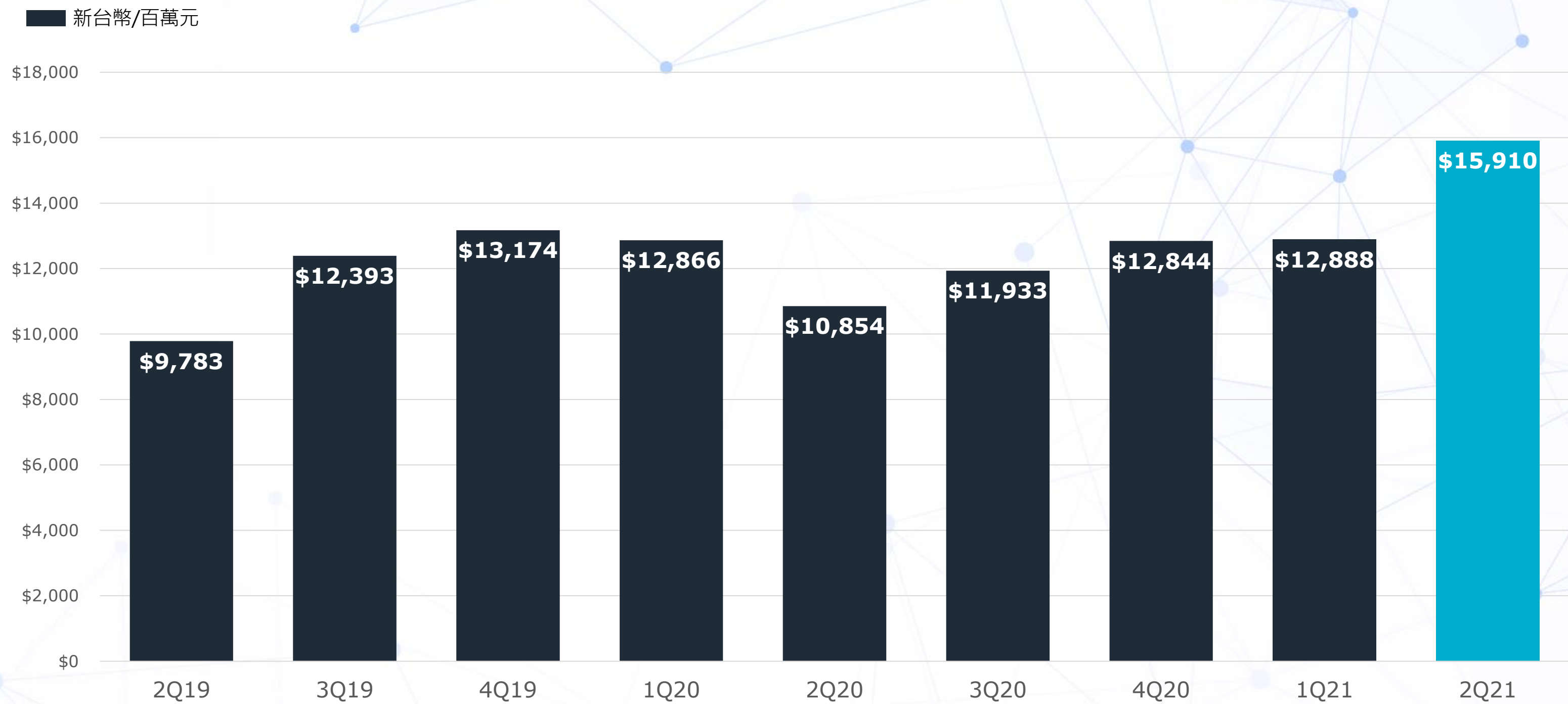
- 20%** 佔第二季整體營收百分比
- 50%** SATA與PCIe SSD控制晶片總出貨量YoY
- 190%** PCIe SSD控制晶片總出貨量YoY

### 模組

- 74%** 佔第二季整體營收百分比
- 28%** BGA SSD記憶體模組總出貨量YoY
- 56%** 工業用記憶體模組營收YoY
- 137%** 遊戲應用記憶體模組營收YoY
- 54%** Embedded ODM記憶體模組營收YoY

# 合併營收

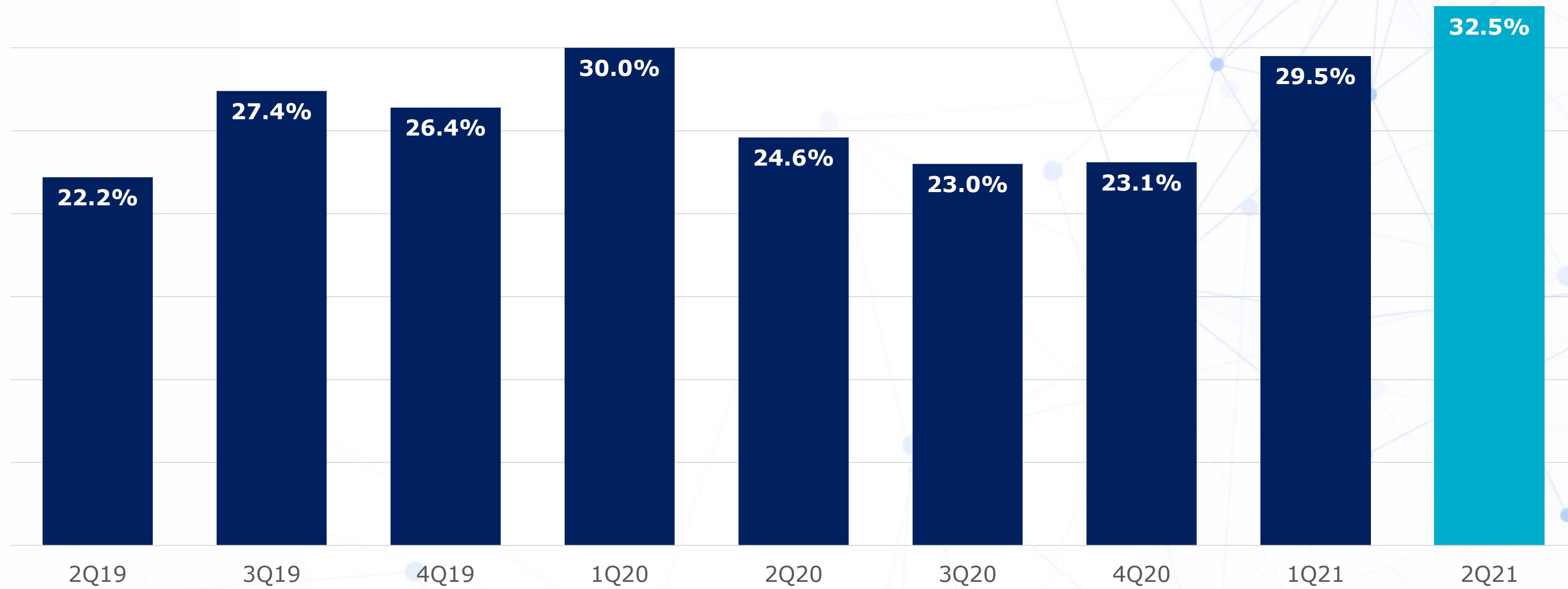
即使面臨產業晶片短缺，本季仍維持穩定的營收成長



# 營業毛利

轉變中的產品組合，使本季毛利率更佳

■ 毛利率 %



# 每股盈餘

群聯獨特的營運模式，趨動強穩的獲利能力

新台幣/元



\*EPS contribution from one-time gain is in red.

# 損益表重點節錄

創歷史同期新高

新台幣/百萬元	2Q21	1Q21	Q/Q (%)	2Q20	Y/Y (%)
營業收入(美金百萬元)	<b>568</b>	<b>455</b>	24.8	<b>363</b>	56.5
營業收入	<b>15,910</b>	<b>12,888</b>	23.4	<b>10,855</b>	46.6
營業毛利	<b>5,164</b>	<b>3,804</b>	35.8	<b>2,673</b>	93.2
營業費用	2,628	1,969	33.5	1,593	65.0
營業利益	<b>2,536</b>	<b>1,835</b>	38.2	<b>1,080</b>	134.8
營業外收益(損失)	220	217	1.4	43	411.6
稅前淨利	<b>2,756</b>	2,052	34.3	1,123	145.4
所得稅	492	364	35.2	-62	893.5
稅後淨利	<b>2,264</b>	<b>1,688</b>	34.1	<b>1,185</b>	91.1
基本每股盈餘 (NT\$)	<b>11.49</b>	<b>8.56</b>	34.2	<b>6.00</b>	91.5
經調整 EBITDA*	<b>3,032</b>	<b>2,275</b>	33.3	<b>1,308</b>	131.8
重要財務比率 (%)					
毛利率	<b>32.5</b>	29.5		24.6	
營利率	15.9	14.2		9.9	
淨利率	14.2	13.1		10.9	
平均匯率(美元/新台幣)	<b>28.17</b>	28.37		<b>30.00</b>	

\*本表之經調整EBITDA 係將稅後淨利加回淨利息，稅金，折舊/攤銷費用和員工股票權費用，以及與處置長期投資相關的其他調整。

# 資產負債表重點節錄

新台幣 / 百萬元	2Q21		4Q20		2Q20	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
<b>總資產</b>	<b>56,124</b>	100.0	<b>47,564</b>	100.0	<b>41,310</b>	100.0
現金及損益以公允價值衡量之金融資產(流動)	19,701	35.1	20,456	43.0	14,825	35.9
應收帳款	8,134	14.5	6,018	12.7	5,151	12.5
存貨	15,600	27.8	10,141	21.3	13,062	31.6
長期性投資	4,588	8.2	4,805	10.1	3,165	7.7
固定資產(淨值)	5,461	9.7	4,647	9.8	3,714	9.0
<b>總負債</b>	<b>21,820</b>	<b>38.9</b>	<b>12,408</b>	<b>26.1</b>	<b>11,461</b>	<b>27.7</b>
流動負債	21,378	38.1	11,763	24.7	11,233	27.2
<b>總股東權益</b>	<b>34,304</b>	<b>61.1</b>	<b>35,156</b>	<b>73.9</b>	<b>29,849</b>	<b>72.3</b>
<b>每股淨值(NT\$)</b>	<b>174</b>		<b>178</b>		<b>151</b>	
<b>重要財務比率</b>						
應收帳款週轉天數	45		45		43	
存貨週轉天數	119		109		131	
股東權益報酬率 (%)	22.8		27.1		20.9	
資產報酬率(%)	15.3		20.2		15.4	

# 七月合併營收

2021年7月合併營收  
**\$54.82億**

營收 年成長42%

創歷史同期新高  
創歷史單月第三高

2021年累計1至7月營收  
**\$384.91億**

營收 年成長24%

創歷史同期新高

\*營收單位為新台幣

# 群聯擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案

- 群聯於8月6日董事會決議通過擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案，群聯因營運發展所需，為購置不動產、廠房及設備之資金需求，並充實營運資金以提高資金調度能力，擬募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債。
- 本次預計發行總張數上限為35,000張，每張債券面額為新台幣100仟元整，預計發行總面額上限為新台幣3,500,000仟元整，依票面金額之100.5%發行，預計發行總金額上限為新台幣3,517,500仟元，發行期間三年，票面利率為0%，擬採詢價圈購方式辦理公開承銷。
- 本案實際發行條件俟呈主管機關申報生效後，將依相關法令規定並視金融環境及市場狀況，訂定發行條件及辦理實際發行作業等相關發行事宜。



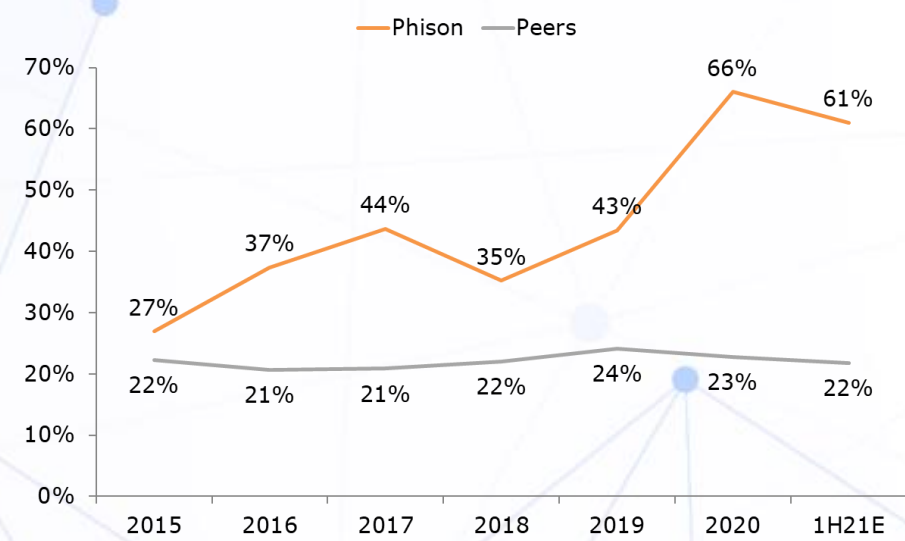
# 發行國內第一次無擔保轉換公司債案之原因

- 半導體產能緊張，需要與半導體供應鏈上游廠商密切合作以確保產能
- NAND市場蓬勃發展，群聯需要擴大營業規模，掌握商機
- 研發人員增加，需要擴增相對應的研發大樓與土地，儲備成長動能

# 築高牆

# 積足糧

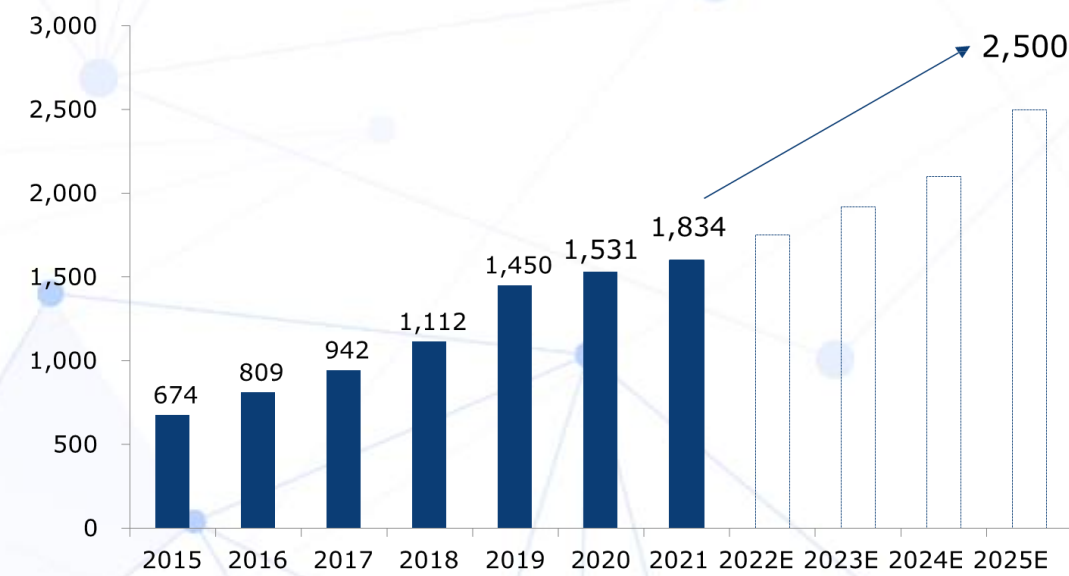
群聯的RD研發強度是同業的2倍以上



\*RD intensity is RD expense/IC related sales.

\*\* Peers include SIMO, Marvell, MediaTek, Realtek, Novatek and Silergy.

群聯的研發工程師預計於2025年達到2500位



群聯 5 + 5 發展大戰略



# 決議通過民國110年上半年度盈餘分配案

群聯於8月6日董事會決議通過民國110年上半年度盈餘分配案，決議配發股東現金股利

# \$10元/股

\*營收單位為新台幣

# 3 營運亮點

# 2021年第二季 營運亮點



## Retail

- Phison started shipping world's fastest E18 Gen4x4 Controller with 176L NAND
- Two NAND makers announced PCIe Gen4 SSD with Phison solutions
- Started shipping USB 3.2 U17 solution for external SSD to NAND maker and retail



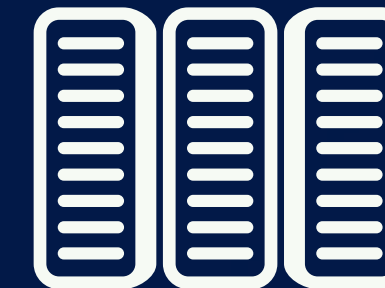
## OEM

- PCIe Gen4 E16 SSD design-in for high-end desktop PC
- Delivering E13T PCIe Gen3 SSD performance to high-end Chromebook
- DRAM-less Gen4 solutions at final stage of OEM qualification



## Gaming

- Delivering PCIe Gen4 E19T performance to cloud gaming platform
- Enabling gaming NB by E18 PCIe Gen4 SSD
- PCIe Gen3 E13T SSD design-in portable gaming device



## Server / DC

- Phison shipping world's highest capacity 15.36TB QLC SATA SSD to U.S. storage OEMs after completion of qualifications



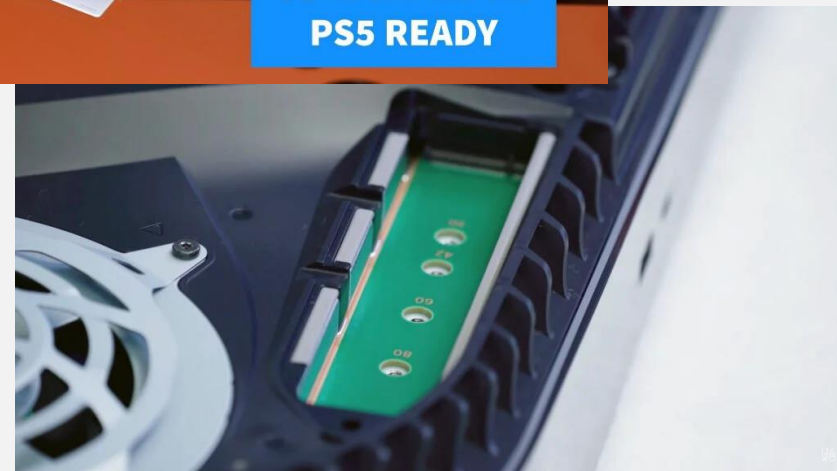
## Industrial

- Phison and Cigent ship first self-defending cybersecurity SSDs
- Powering factory automation robots by SATA S11T SSD
- Enabling car Blackbox by uSSD solution
- Delivering industrial grade microSD for smart meters in Russia
- PCIe Gen3 E13T design-in for digital signage platform

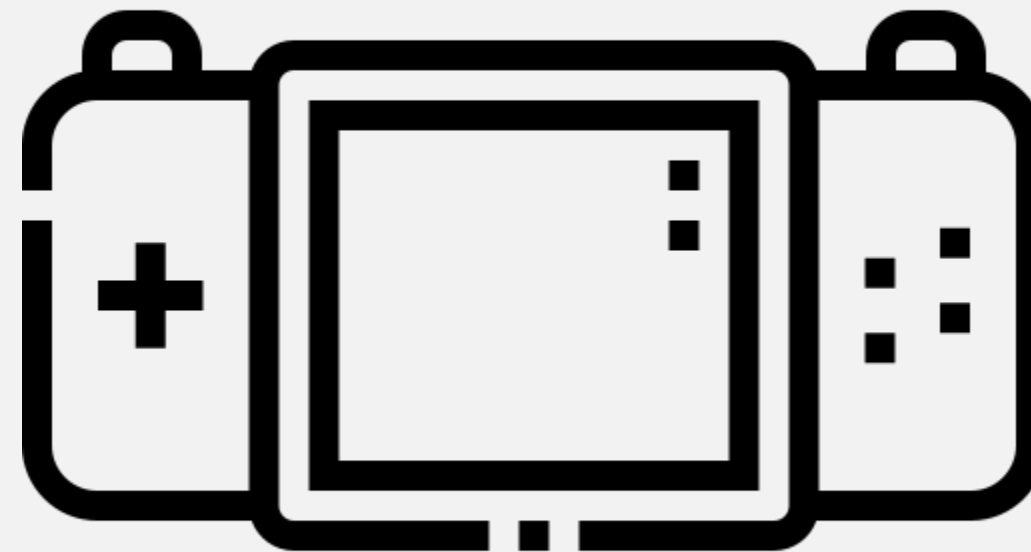
# 2021年第三季 NAND儲存市場需求亮點



**SONY IS FINALLY ALLOWING PS5 USERS TO EXPAND SSD STORAGE**



**2021 is the Year of the Gaming Handheld, Said CNET**



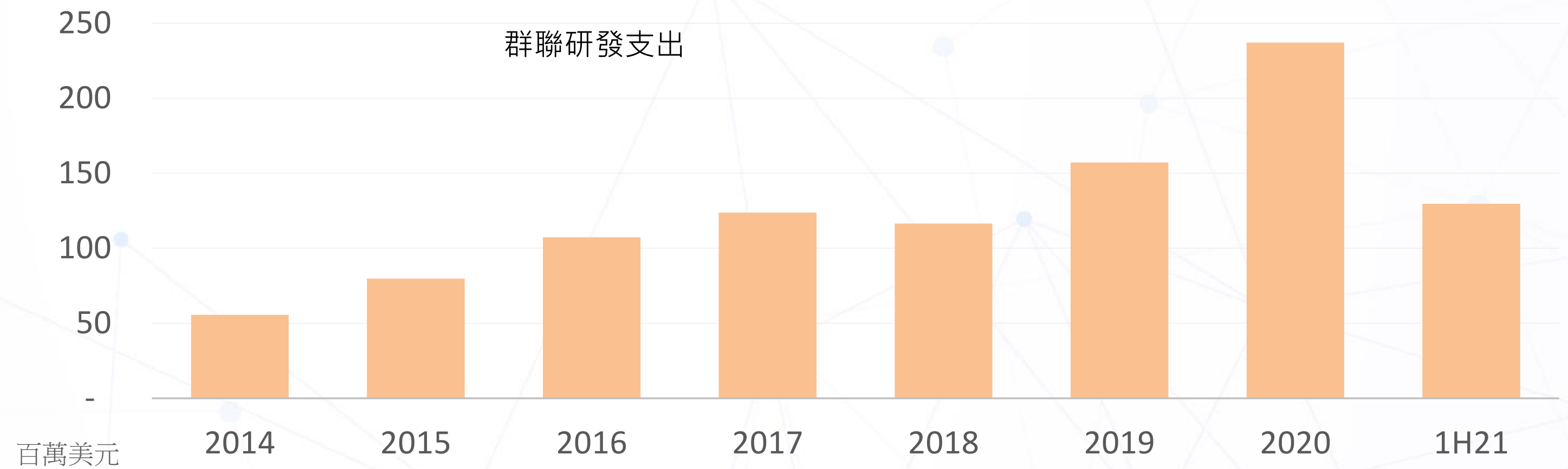
**Phison and Cigent Partnership Sets New Standard in Cybersecurity with Self-Defending Flash Storage Drives**



## **4** 現在與未來的技術領先優勢

# 透過研發投資 持續強化技術領先地位(1/2)

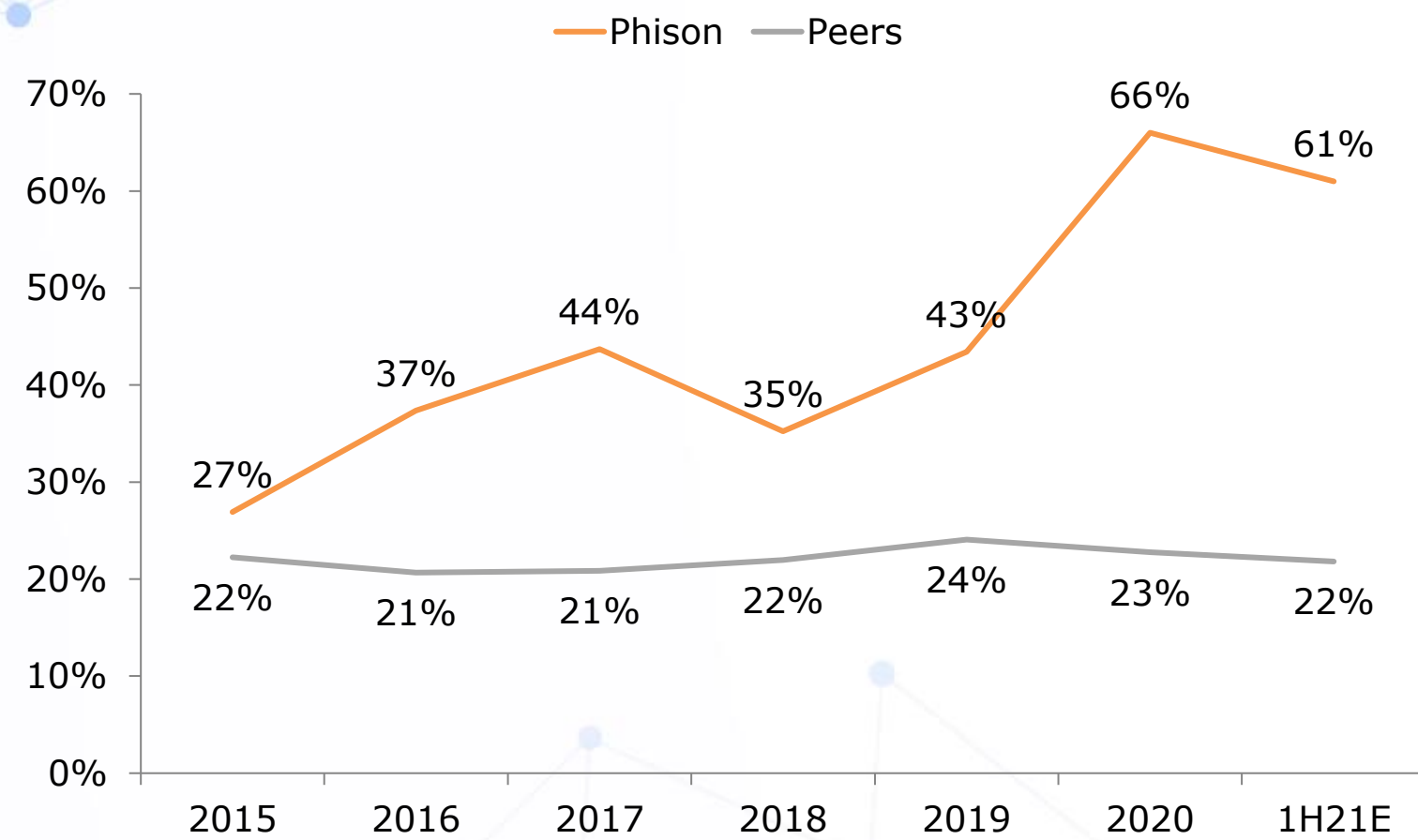
Category	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1H21
研發人數	530	674	809	942	1,112	1,450	1,531	1,834
研發支出佔營業收入比 (%)	5%	6%	7%	9%	9%	11%	14%	13%
研發支出佔營業費用比 (%)	65%	71%	73%	78%	79%	79%	81%	80%





# 透過研發投資 持續強化技術領先地位(2/2)

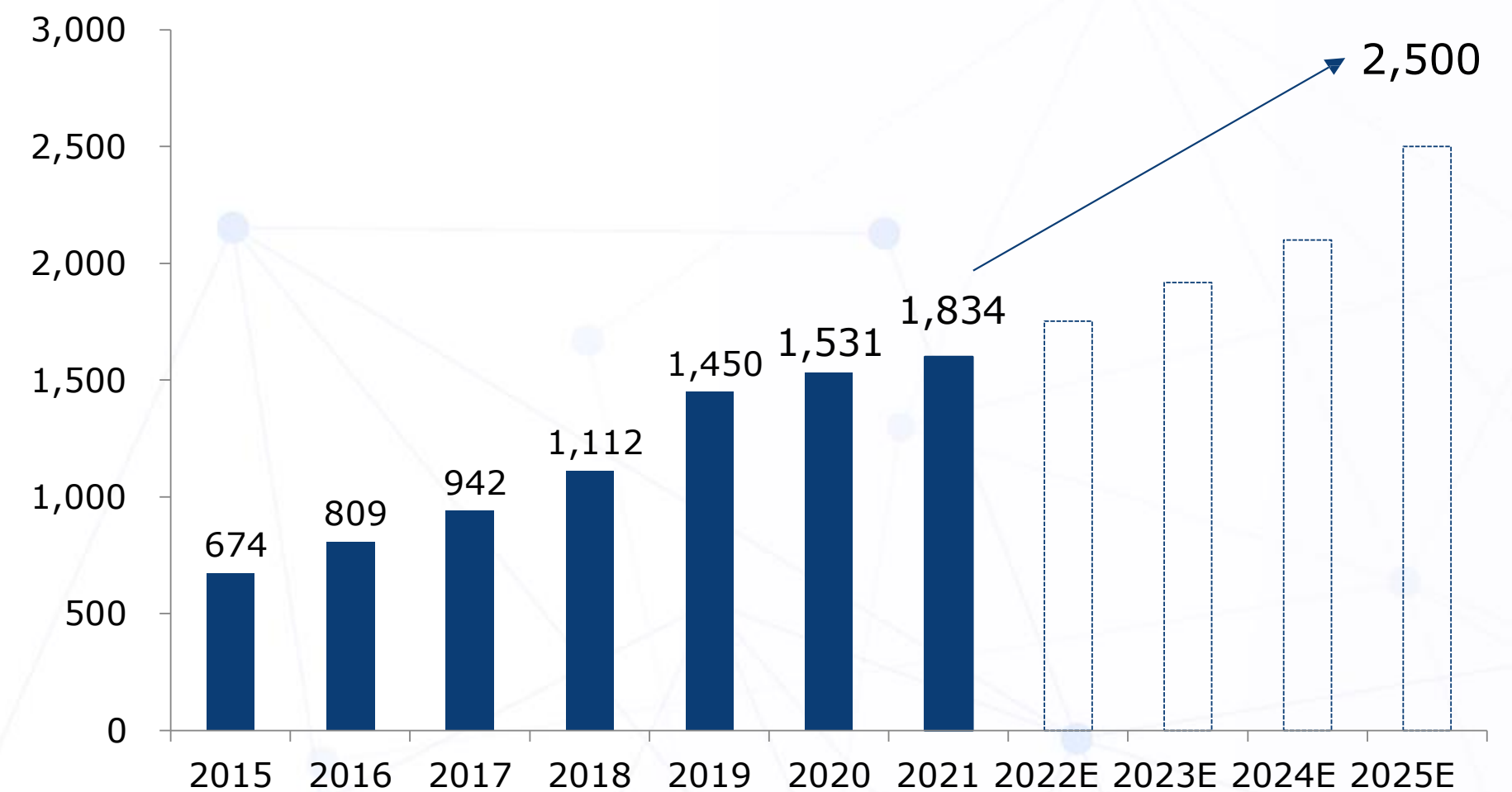
群聯的RD研發強度是同業的2倍以上



\*RD intensity is RD expense/IC related sales.

\*\* Peers include SIMO, Marvell, MediaTek, Realtek, Novatek and Silergy.

群聯的研發工程師預計於2025年達到2500位



**Thank you**